## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-239032

(43)Date of publication of application: 27.11.1985

(51)Int.CI.

#### H01L 21/58

(21)Application number: 59-092954

(71)Applicant: TOKYO TUNGSTEN CO LTD

(22)Date of filing:

11.05.1984 (72)Inven

(72)Inventor: OKAMOTO KENICHI

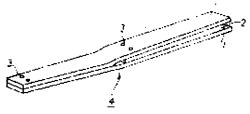
MORI MICHIO SAITO AKIRA

# (54) MANUFACTURE OF COPPER-MOLYBDENUM COMPOSITE ELECTRODE MATERIAL (57)Abstract:

PURPOSE: To enable to obtain simply a composite electrode material having superior peel resistance,

etc. by a method wherein the surfaces of an Mo plate are made rough, and a composite plate formed by arranging with copper plates on the respective surfaces of the Mo plate made rough is rolled in the specified atmosphere and condition.

CONSTITUTION: A roughing process of a surface to roughness of 5W30  $\mu$  m on an average is performed at least to one surface of an Mo plate 2. Then the Mo plate 2 is put between copper plates 1, and spot weldings 3 are performed to the neighborhood of the left edge of the copper plates 1 and to the neighborhood of the left edge of the Mo plate 2 to fix temporarily the fellow copper plates 1, and the copper plates 1 and the Mo plate 2. Rolling processings of the plural number of times are performed to the composite plate 4 thereof heating at 700W 950° C in a hydrogen gas or an inactive gas atmosphere having



oxygen content of 500ppm or less in this condition to manufacture the copper. Mo composite electrode material. The copper. Mo composite electrode material manufactured in such a way has superior peel resistance, and moreover, no warp is generated during employment.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### ⑲ 日本 囯 特 許 庁 ( J P )

40 特許出願公告

#### ⑫ 特 許 公 報(B2)

平2-852

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

200公告 平成2年(1990)1月9日

H 01 L 21/52

8728-5F 8728-5F CB

発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称 銅・モリブデン複合電極材料の製造方法

> ②特 顧 昭59-92954

码公 昭60-239032

**②**出 類 昭59(1984)5月11日 ❷昭60(1985)11月27日

個発 明 者 岡 本 謎 富山県富山市岩瀬古志町2番地 東京タングステン株式会 社富山工場内

@発 明 者 森 道 雄

富山県富山市岩瀬古志町2番地 東京タングステン株式会

社富山工場内

⑦発 鄋 者 斉 銮 明

東京都練馬区下石神井3-6-32

る出 頣 人 東京タングステン株式

東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号

会社

四代 理 人 弁理士 芦田 坦

外2名

査 官 河 合

耷

1

#### **釣特許請求の範囲**

1 モリプデン板材の少なくとも一面を平均5~ 30μmの表面粗さで粗面化し、該粗面化された面 に銅板を配置した複合板を、酸素含有量が 気中において、700乃至950℃に加熱して、前記雰 囲気中で、複数回の圧延加工を行うようにし該圧 延加工のうち最初の圧延加工の圧延率が35乃至55 %であることを特徴とする銅・モリブデン複合電 極材料の製造方法。

#### 発明の詳細な説明

#### (産業上利用分野)

本発明は複合電極材料、特に、半導体の支持に 用いられる複合電極材料の製造方法に関する。

#### 〔従来技術〕

従来から半導体支持用の電極材料として、半導 体の熱膨張率に極めて近い熱膨張率を持つタング ステン(W)及びモリブデン(Mo)が用いられ てきた。

質としては、熱伝導性が良いこと、電気伝導性が 良いこと及び半導体とのろう付性が良い(半導体 をしつかりと固定できる)ことなどである。この

点に鑑みて、モリブデン材と銅とを複合した複合 電極材料が提案されている。

2

ところが、モリブデン材は2600℃という高温の 融点を有するとともに加工が困難である。一方、 500ppm以下の水素ガスあるいは不活性ガス雰囲 5 銅は比較的融点も低く、加工性も良いというモリ プデンと相反する性質を持つており、したがつ て、モリプデン板材の片面あるいは両面に銅板を 配置する場合、これをメッキ処理する方法によっ て複合化しているが、このメッキ処理は非常に面 10 倒であり、また、非常に不経済であつたのであま り用いられていない。

従来、一般に用いられている複合電極材料の製 造方法は、(1)モリブデン板材と銅板との間に接着 媒介層を設けて、冷間圧延を行い、モリブデン板 15 材と銅板材を接合し、複合電極材料を作製する方 法、またはモリブデン板材と銅板材とをろう付す る方法、(2)モリブデン板材と銅板とを重ね合わせ て熱間圧延加工によって接合して複合電極材料と する方法、(3)モリブデン板材と銅板を重ね合わせ 一般に、半導体支持用電極材料に求められる性 20 て、これをステンレス合金などで包んで加熱圧延 を行なつた後、ステンレス合金を除去する方法、 などである。

ところが、上配の(1)においては、接着媒介層や

ろう付部分に不均一が生ずることが避けられず、 接着強度にムラがあり、この複合電極材料を用い た場合、モリブデンと銅との熱膨張率の相違によ つて、モリブデン板と銅板とが剝離したり、複合 電極材料が反るなどの問題点がある。また上記の (2)の方法においては、モリブデン及び銅は大気中 での加熱によつてその表面に酸化物膜を形成し易 く、特にモリプデンでは大気中で500℃以上に加 熱すると、モリプデンの表面上に形成された酸化 物膜が昇華してしまうという問題点があり、熱間 10 900℃に保持した。 圧延を行う雰囲気及び加熱温度等を決定すること が難しく、モリブデン板と銅板とを完全に接合す ることが困難である。上記(3)の方法では、モリブ デン板及び銅板をステンレス合金で包む際の脱気 処理や、圧延後の複合電極材料を取り出す作業が 15 非常に面倒であるという問題点がある。

#### 〔発明の目的〕

本発明の目的は、使用中に剝離や反りを生じる ことのないモリブデン・銅復合電極材料を容易に 製造することのできる方法を提供することであ 20 にして作製された銅・モリブデン複合電極材料は る。

#### 〔発明の構成〕

本発明では、モリブデン板材の少なくとも一面 を平均5万至30μmの表面租さで租面化し、該租 面化された面のそれぞれに銅板を配置した複合板 25 件を種々変化させて、作製後の銅・モリブデン複 を、酸素含有量が500ppm以下の水素ガスあるい は不活性ガス雰囲気中において、700乃至950℃に 加熱して、前記雰囲気中で複数回の圧延加工を行 うようにしたことを特徴とする銅・モリブデン復 合電極材料の製造方法が得られる。なお、前記復 30 数回の圧延加工のうちの最初の圧延加工の圧延率 が35乃至55%であればよい。

#### 〔発明の実施例〕

び下、本発明について実施例を基に説明する。 2枚、厚さ1mm×幅70mm×高さ3500mmの純モリブ デン板1枚を準備する。このモリプデン板の表面 及び裏面の2面に対して、液体ホーニング装置を 用いて、平均20μmの表面租さに処理した。また 上記の銅板及びモリブデン板からは予め酸化物被 40 つてしまう。 膜及び油脂分を除去した。

次に第1図に示すように、モリブデン板2を銅 板1ではさみ、銅板1の左端近傍及びモリブデン 板2の左端近傍にスポット溶接3(あるいは銅鋲

でもよい)を施して、銅板1同士及び銅板1とモ リブデン板2とを仮りに固定する。(以下これを 複合板素材と呼ぶ)。さらに第2図を参照すると、 この複合板素材4は電気炉5中に挿入され、この 複合板素材 4 の先端部 (第1図において左側) は 圧延機8に挿入されている。この状態において、 ガス送入口7より、含有酸素量が100ppm以内の 水素ガスを電気炉5内に送り込むとともに、電気 炉5の加熱ヒータ51に通電して、炉内温度を

次に圧延機 8 を回転させて、複合板素材 4 を図 中左側に移動させて、第1回目の圧延を行なつ た。なおこの時の圧延率は40%に保持した。さら に上配の炉内雰囲気において熱間圧延を行ない、 最終的に複合板素材 4 の厚さを 1 mmとした。その 後、この熱間圧延された複合板素材4を電気炉6 から取り出して、表面を洗浄し、室温において所 定の厚さに冷間加工(圧延)をして、銅・モリブ デン複合電極材料を作製した。そして、このよう 耐剝離性がすぐれており、また使用中に反りが発 生しないことがわかつた。

ところで、発明者らは上述した銅・モリプデン 複合電極材料の作製にあたつて、予め設定した条 合電極材料について調べたところ、設定条件と 銅・モリブデン複合電極材料の性質(特性)との 関係は次のとおりであつた。なお、使用した銅板 及びモリブデン板の寸法は前述の実施例と同一の ものを使用し、表示しない設定条件は実施例と同 じとした。

複合板素材を作製するにあたつて、モリブデン 板の表面粗さを平均で5μπ以下とした場合、銅 板とモリブデン板との接着強度が低下し、したが まず、厚さ1mm×幅70mm×高さ4500mmの純銅板 35 つて複合電極材料が剝離現象を生ずることがあ る。またモリブデン板の表面粗さが平均30μπを 超えると、熱間圧延時において、銅板とモリブデ ン板との摩擦抵抗が大きいため、複合板素材を所 定の厚さに圧延するための制御が極めて困難とな

> 次に、電気炉内の雰囲気について実験したとこ ろ、電気炉内に送入される水素ガスに含有される 酸素量が550ppmを超えると、熱間圧延中におい てモリブデン板と銅板との圧接面に微量の酸化物

が形成され、この酸化物によつて部分的に接合状 態の不良があらわれ、複合電極材料の使用中に、 この接合不良箇所にふくらみなどが発生して、電 極として性能が劣化した。さらに、電気炉内の温 1000~1050℃に設定することが好ましいけれど も、上記の温度範囲では銅の軟化が著しく、圧延 することは不適当であり、さらに、モリプデンの 再結晶温度は約950℃であるため、電気炉内温度 は800~950℃に設定することが最もよく、銅板と 10 (発明の効果) モリブデン板とをしつかりと圧接することができ る。炉内温度が750℃を下まわると銅板の軟化が 不足して、モリブデン板と銅板との接合強度が低 くなつて、複合電極材料の使用時に剝離現象が生 ずることがある。

さらに、圧延機による圧延率についても調べた ところ、複数回行う熱間圧延において、最初の圧 延の圧延率は35%以上を必要とし、圧延率が30% 以下となると、モリブデン板と銅板との接合状態 が低下し、複合電極材料に剝離現象が生ずること 20 ある。 がある。また最初の圧延率が55%を超えた場合、 銅とモリブデンとは特性(加工性)が相違するた め、複合板素材を所定の厚さに制御することが極

めて困難となつてしまう。甚だしい場合には、 板とモリブデン板との加工硬化量の相異によっ。 て、モリブデン板が割れる場合もある。なお、最 初の圧延率は好ましくは40~50%とするほうがよ 度は、圧接の観点からすれば、銅の融点に近い 5 いことがわかつた。なお上述の実施例ではモリブ デン板の両面を粗面化し、この両面に銅板を配置 する場合について述べたが、片面を粗面化して、 この面に銅板を配置して複合電極材料としてもよ 410

以上、説明したように本発明による製造方法を 用いれば、耐剝離性等のすぐれた銅・モリブデン 複合電極材料が得られるばかりでなく、特別の器 具等を使用する必要がなく、極めて簡便な製造方 15 法が得られる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は銅板及びモリブデン板による複合板素 材を示すための斜視図、第2図は第1図に示した 複合板素材を熱間圧延する状態を示すための図で

1 ……銅板、2 ……モリブデン板、3 ……スポ ツト溶接、4……複合板素材、5……電気炉、8 ……圧延機、7……水素送込口。

